

Design Di Porta Wafer In Ptfе Personalizzata A Cestello A Fiore Resistente Chimico Con Maniglia Per La Pulizia Dei Semiconduttori

Numero articolo: PL-CP166



introduzione

Massimizza la resa dei semiconduttori con porta wafer in PTFE personalizzati e cestelli a fiore. Progettati per una resistenza superiore all'acido fluoridrico e ai reagenti aggressivi, questi sistemi di manipolazione ad alta purezza presentano maniglie ergonomiche e slot lavorati a CNC con precisione per una pulizia a umido sicura e priva di contaminazioni.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Processi di Pulizia RCA	Pulizia sequenziale utilizzando soluzioni SC-1 e SC-2 per rimuovere residui organici e contaminanti metallici.	Resiste ad alto pH e stress ossidativo senza rilasciare impurità nel bagno.
Incisione con Acido Fluoridrico	Rimozione di strati di ossido nativo o strati di vetro sacrificali da wafer di silicio utilizzando HF concentrato.	Resistenza completa all'HF, che altrimenti scioglierebbe il vetro o degraderebbe le plastiche standard.
Incisione / Stripping Piranha	Rimozione di contaminazione organica pesante o fotoresist utilizzando una miscela di acido solforico e perossido di idrogeno.	Mantiene l'integrità strutturale alle alte temperature esotermiche generate dalle soluzioni Piranha.
Sviluppo Fotolitografico	Immersione dei wafer in soluzioni di sviluppo per definire i pattern dei circuiti dopo l'esposizione UV.	La precisione degli slot assicura un'esposizione uniforme della superficie del wafer al fluido di sviluppo.
Risciacquo Post-CMP	Risciacquo ad alta purezza seguente la Lucidatura Meccanica Chimica (CMP) per rimuovere le particelle della slurry.	La superficie antiaderente previene l'accumulo di slurry e facilita una decontaminazione rapida e completa.
Fab di Semiconduttori Composti	Lavorazione di wafer GaAs, InP o SiC per l'elettronica ad alta frequenza e la produzione di LED.	Le caratteristiche di manipolazione delicata prevengono la frattura di materiali composti più fragili.
Pulizia Ultrasonica / Megasonica	Supporto dei wafer durante la pulizia acustica ad alta frequenza per dislocare particelle sub-microniche.	Eccellente smorzamento delle vibrazioni e stabilità chimica sotto le forze di cavitazione acustica.
Categoria di Specifica	Dettagli Parametro per PL-CP166	Opzioni di Personalizzazione
Materiale Principale	PTFE Vergine ad Alta Purezza (Politetrafluoroetilene)	PFA opzionale per maggiore trasparenza/purezza
Compatibilità Dimensione Wafer	4 pollici (100mm), 6 pollici (150mm), 8 pollici (200mm)	Diametri personalizzati e forme non standard disponibili
Configurazione Slot	Profili a V-groove o U-groove di precisione	Passo, profondità e spaziatura angolare degli slot personalizzati
Capacità	Configurazioni standard da 25 o 50 wafer	Dimensioni di lotti su misura da singolo wafer ad alto volume
Design Maniglia	Integrata a montaggio superiore o laterale	Maniglie rimovibili, estese o compatibili con l'automazione
Resistenza Chimica	Spettro completo (Acidi, Basi, Solventi, Ossidanti)	Verificata per HF, H2SO4, HNO3, HCl, NH4OH, ecc.
Temperatura di Funzionamento	-200°C a +260°C	Adattata a profili specifici di cicli termici
Metodo di Fabbricazione	Lavorazione CNC Personalizzata End-to-End	Controllo di tolleranza di precisione per interfaccia automatizzata

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Categoria di Specifica	Dettagli Parametro per PL-CP166	Opzioni di Personalizzazione
Protocollo di Pulizia	Lavato in camera bianca e sigillato sottovuoto	Pre-pulizia specializzata per l'analisi delle tracce